



2023年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年11月10日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2022年11月11日

配当支払開始予定日

2022年12月7日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期第2四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第2四半期	1,182,897	26.9	350,165	27.5	353,319	27.2	267,346	33.5
2022年3月期第2四半期	932,514	39.6	274,647	86.3	277,762	87.4	200,219	78.7

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 259,972百万円 (15.8%) 2022年3月期第2四半期 224,552百万円 (81.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第2四半期	1,715.27	1,707.84
2022年3月期第2四半期	1,286.74	1,279.96

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第2四半期	2,138,073	1,492,192	69.2
2022年3月期	1,894,457	1,347,048	70.5

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 1,479,333百万円 2022年3月期 1,335,152百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期		643.00		760.00	1,403.00
2023年3月期		857.00			
2023年3月期(予想)				625.00	1,482.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

2023年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当425円、創立60周年記念配当200円です。

3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,100,000	4.8	546,000	8.9	549,000	8.8	400,000	8.5	2,564.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2023年3月期2Q	157,210,911 株	2022年3月期	157,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2023年3月期2Q	1,173,271 株	2022年3月期	1,461,581 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2023年3月期2Q	155,862,311 株	2022年3月期2Q	155,602,587 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2023年3月期2Q 503,034株、2022年3月期 610,529株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2022年11月10日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) キャッシュ・フローに関する説明	4
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業的前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済につきましては、地政学リスクの高まりに伴う資源・エネルギー価格の高騰による物価の上昇、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げや急激な為替変動、新型コロナウイルス感染症に伴う一部地域でのサプライチェーンへの影響等、注視すべき状況が継続しました。

一方、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、半導体の重要性が高まっており、半導体製造装置市場は中長期的な成長が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1兆1,828億9千7百万円(前年同期比26.9%増)、営業利益3,501億6千5百万円(前年同期比27.5%増)、経常利益3,533億1千9百万円(前年同期比27.2%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,673億4千6百万円(前年同期比33.5%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資は、社会のデジタル化を背景に、最先端から成熟世代まで幅広い範囲で投資がおこなわれました。DRAM向け設備投資は、在庫調整に伴う見直しがありましたが、NANDフラッシュメモリ向け設備投資は、高積層化に伴う需要により高い水準で推移しました。

このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1兆1,530億6千5百万円(前年同期比27.3%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向け設備投資が一巡したことにより、FPD TFTアレイ向け製造装置市場全体としては減速傾向となりました。一方、中小型有機ELパネル向け設備投資については、最終製品に搭載されるディスプレイが液晶から有機ELへと転換されることに伴う投資が継続しました。

このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、297億5千9百万円(前年同期比11.5%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、7千3百万円(前年同期比7.3%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	932,514	1,071,291	1,182,897	709,243
半導体製造装置	905,763	1,038,080	1,153,065	689,061
日本	108,827	120,075	132,569	90,546
北米	105,808	162,257	175,630	108,305
欧州	33,721	74,232	107,516	50,990
韓国	188,812	188,955	169,461	84,289
台湾	165,401	193,824	230,645	133,829
中国	262,509	251,020	262,685	168,598
東南アジア他	40,683	47,714	74,557	52,502
FPD製造装置	26,682	33,147	29,759	20,144
その他	68	63	73	36
営業利益	274,647	324,623	350,165	232,646
経常利益	277,762	323,962	353,319	235,627
親会社株主に帰属する 四半期純利益	200,219	236,856	267,346	179,251

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,311億6千8百万円増加し、1兆6,398億7千1百万円となりました。主な内容は、現金及び預金の増加1,804億1千5百万円、棚卸資産の増加791億3千8百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加738億3百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少669億9千9百万円、未収消費税等の減少447億9千5百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から231億3百万円増加し、2,461億8千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から38億1千7百万円増加し、263億5千7百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から144億7千3百万円減少し、2,256億6千2百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から2,436億1千6百万円増加し、2兆1,380億7千3百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ942億2千4百万円増加し、5,628億3百万円となりました。主として、前受金の増加857億9千5百万円、未払法人税等の減少152億6千3百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ42億4千8百万円増加し、830億7千7百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,451億4千4百万円増加し、1兆4,921億9千2百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益2,673億4千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当1,188億3千3百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は69.2%となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,189億5千5百万円増加し、4,546億3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資300億8千7百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,134億1千6百万円増加し、4,846億9千万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ574億7千6百万円増加の2,633億9千1百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益3,529億1千6百万円、前受金の増加848億4千万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,093億3百万円、棚卸資産の増加692億1千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出327億9千2百万円により、前年同期の257億8千5百万円の支出に対し342億1千万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,188億3千3百万円により、前年同期の661億9千万円の支出に対し1,212億6千9百万円の支出となりました。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間につきましては、売上高は前回予想を上回り、利益面につきましても営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益それぞれ過去最高を更新する結果となりました。

今後の事業環境につきましては、マクロ経済の減速懸念や地政学リスクにより、半導体メーカーの設備投資先送り・抑制の傾向が見られております。

このような状況のもと、売上高が前回予想を下回る見込みとなりましたので、2022年5月12日に公表した通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

2023年3月期第2四半期累計期間の連結業績

	当期上半期実績	前回予想 (2022年5月12日公表)
売上高	1兆1,828億円 (前年同期比 26.9%増)	1兆1,000億円
半導体製造装置	1兆1,530億円 (前年同期比 27.3%増)	1兆700億円
F P D製造装置	297億円 (前年同期比 11.5%増)	300億円
営業利益	3,501億円 (前年同期比 27.5%増)	3,190億円
経常利益	3,533億円 (前年同期比 27.2%増)	3,190億円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,673億円 (前年同期比 33.5%増)	2,340億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2023年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2022年5月12日公表)
売上高	2兆1,000億円 (前期比 4.8%増)	2兆3,500億円
半導体製造装置	2兆460億円 (前期比 5.3%増)	2兆2,950億円
F P D製造装置	540億円 (前期比 9.7%減)	550億円
営業利益	5,460億円 (前期比 8.9%減)	7,160億円
経常利益	5,490億円 (前期比 8.8%減)	7,160億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,000億円 (前期比 8.5%減)	5,230億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	274,274	454,689
受取手形、売掛金及び契約資産	433,948	507,751
有価証券	97,000	30,001
商品及び製品	183,512	204,451
仕掛品	144,330	159,207
原材料及び貯蔵品	146,002	189,324
その他	129,796	94,623
貸倒引当金	△160	△177
流動資産合計	1,408,703	1,639,871
固定資産		
有形固定資産	223,078	246,181
無形固定資産		
その他	22,540	26,357
無形固定資産合計	22,540	26,357
投資その他の資産		
その他	241,434	227,036
貸倒引当金	△1,298	△1,373
投資その他の資産合計	240,135	225,662
固定資産合計	485,754	498,202
資産合計	1,894,457	2,138,073

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	120,908	125,888
未払法人税等	107,193	91,929
前受金	102,555	188,351
賞与引当金	44,871	41,643
製品保証引当金	26,568	35,644
その他の引当金	5,353	2,458
その他	61,129	76,887
流動負債合計	468,578	562,803
固定負債		
その他の引当金	6,402	3,172
退職給付に係る負債	62,533	62,935
その他	9,894	16,969
固定負債合計	78,829	83,077
負債合計	547,408	645,881
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,104,983	1,252,548
自己株式	△27,418	△23,428
株主資本合計	1,210,537	1,362,091
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	93,492	65,178
繰延ヘッジ損益	△52	△10
為替換算調整勘定	30,640	51,735
退職給付に係る調整累計額	535	339
その他の包括利益累計額合計	124,615	117,242
新株予約権	11,895	12,859
純資産合計	1,347,048	1,492,192
負債純資産合計	1,894,457	2,138,073

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
売上高	932,514	1,182,897
売上原価	509,639	654,081
売上総利益	422,874	528,816
販売費及び一般管理費		
研究開発費	75,547	91,313
その他	72,679	87,337
販売費及び一般管理費合計	148,226	178,651
営業利益	274,647	350,165
営業外収益		
受取配当金	918	1,152
持分法による投資利益	867	1,212
補助金収入	240	1,060
その他	1,595	1,769
営業外収益合計	3,621	5,195
営業外費用		
為替差損	153	1,293
その他	353	748
営業外費用合計	506	2,041
経常利益	277,762	353,319
特別利益		
固定資産売却益	3	2
特別利益合計	3	2
特別損失		
固定資産除売却損	137	405
付加価値税追徴税額	4,577	—
特別損失合計	4,714	405
税金等調整前四半期純利益	273,050	352,916
法人税等	72,830	85,570
四半期純利益	200,219	267,346
親会社株主に帰属する四半期純利益	200,219	267,346

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
四半期純利益	200,219	267,346
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	22,650	△28,307
為替換算調整勘定	1,205	20,804
退職給付に係る調整額	414	△187
持分法適用会社に対する持分相当額	62	316
その他の包括利益合計	24,332	△7,373
四半期包括利益	224,552	259,972
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	224,552	259,972

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	273,050	352,916
減価償却費	16,792	19,622
のれん償却額	103	107
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,785	△4,374
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	3,358	8,864
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△71,745	△64,681
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△27,585	△69,215
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,381	△3,610
未収消費税等の増減額 (△は増加)	31,247	44,856
前受金の増減額 (△は減少)	22,871	84,840
その他	2,871	1,514
小計	254,130	370,840
利息及び配当金の受取額	1,522	1,854
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△49,738	△109,303
営業活動によるキャッシュ・フロー	205,914	263,391
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	481	581
短期投資の増減額 (△は増加)	5,014	5,000
有形固定資産の取得による支出	△25,645	△32,792
無形固定資産の取得による支出	△4,977	△5,175
その他	△658	△1,823
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,785	△34,210
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△8	△1,708
配当金の支払額	△65,746	△118,833
その他	△436	△727
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,190	△121,269
現金及び現金同等物に係る換算差額	432	11,043
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	114,370	118,955
現金及び現金同等物の期首残高	265,993	335,648
現金及び現金同等物の四半期末残高	380,364	454,603

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ、及びウェーハレベルのボンディング/デボンディング装置などの半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	1,153,065	29,759	17,169	1,199,994	△17,096	1,182,897
セグメント利益	386,160	1,390	504	388,055	△35,139	352,916

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△35,139百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△14,435百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。